

TP300-S 系列

导热硅胶垫片

TP 300是一种非常柔软的间隙填充垫，也利用了特殊的导热特性。TP 300能满足众多设计要求和规格的设计需求。TP 300将提供您的设计所需的固有热要求，而不会对组件或外壳施加过度压力。



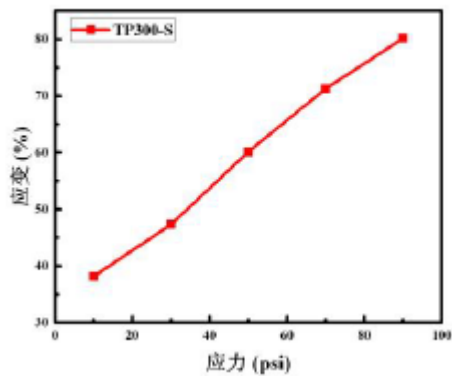
特性与优点

- 导热系数: 3.0 W/m.K
- 超软，高度兼容
- 自然粘性，易于使用
- 高电气绝缘
- 低压力应用，具有高压缩比
- 良好的耐温性能

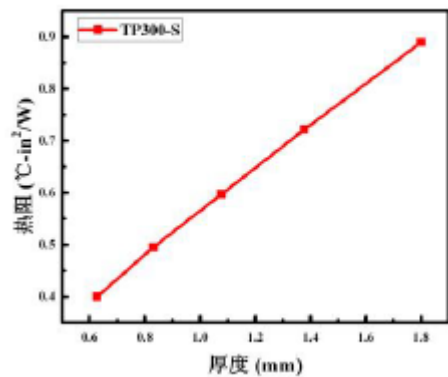
典型应用

- 网络和电信
- It：笔记本电脑，平板电脑，电源转换器
- 工业：led，电源和转换
- 汽车：控制模块，涡轮执行器
- 消费电子产品:游戏系统和液晶显示器

形变量与压力关系图



厚度与热阻关系图



典型属性

属性	典型值	测试方法
	TP300-S	-
成分	有机硅+陶瓷	-
颜色	浅蓝色	目视
厚度(mm)	0.5~8.0	ASTM D374
密度(g/cc)	3.0	ASTM D792
硬度(Shore OO)	50	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~150	/
电性能		
击穿电压(kV/mm)	> 5.0	ASTM D149
体积电阻率 (Ω.cm)	10 ¹³	ASTM D257
介电常数@1MHz	7.3	ASTM D150
防火性能	V-0	UL 94
导热性能		
导热系数(W/m-K)	3.0	ISO 22007-2

存储：

- 储存于阴凉、干燥、通风环境

保质期：

- 12个月。